

## 5- 17 Signetics

企業名	Signetics Corp.
所在地	483 Beopheung-ri, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL	+82-31-940-7888
URL	<a href="https://www.signetics.com/">https://www.signetics.com/</a>
代表者	Jae-Heung Kim
2019年度全社売上高 (US\$million)	191
2020年度全社売上高見込 (US\$million)	160

Signetics

## 1) 事業戦略

● 2000年に韓 Young Poong グループの傘下に入っている。2011年まではメモリの比率が過半数を占めていたが、メモリメーカーの OSAT メーカーの選別、分散化が進んだことで同社への発注が減少し、近年はメモリ売上高の比率が低下している。このため、スマートフォン、タブレットといった携帯機器向けの小型、薄型パッケージに注力しており、車載用途などの新規アプリケーションの開拓を進めている。また、フリップチップラインの生産能力を強化し、FCBGA や e-MCP といった高付加価値品の比率を上げることで、収益性の向上を図る。

● 2019年度の全社売上高は、対前年度比約 15.9%減の約 1 億 9,100 万 US ドルとなった。自国向けが全社売上高の約 55.9% を占めており、主要顧客 3 社向けが約 73.8% を占める。また、メモリ売上高が約 42.2% で、韓 Samsung Electronics 社が主要顧客となっている。2020年度の全社売上高は、同約 16.2% 減の約 1 億 6,000 万 US ドルとなった。

## 2) 設備投資

● 製造は韓国 Paju (坡州市) の本社工場で行っている。同工場では S1 から S4 までの 4 工場棟が稼働しており、このうち S4 棟はフリップチップ工場となっている。さらに 2017 年度から S5 棟の建設を進めており、同棟も既に稼働を開始しているものとみられる。生産能力は 2017 年度が約 8 億 8,500 万個、2018 年度が約 9 億 4,000 万個、2019 年度が約 11 億 6,300 万個となった。

GNC 推定

533



● 2019 年度の設備投資は、対前年度比約 63.6% 減の約 400 万 US ドルとなった。S5 向けの投資が一段落したことに加えて、メモリ市場の低迷に伴って投資を抑制したものとみられる。2020 年度の設備投資は、同約 25.0% 増の約 500 万 US ドルと予測する。

### 3) 開発と今後の方向性

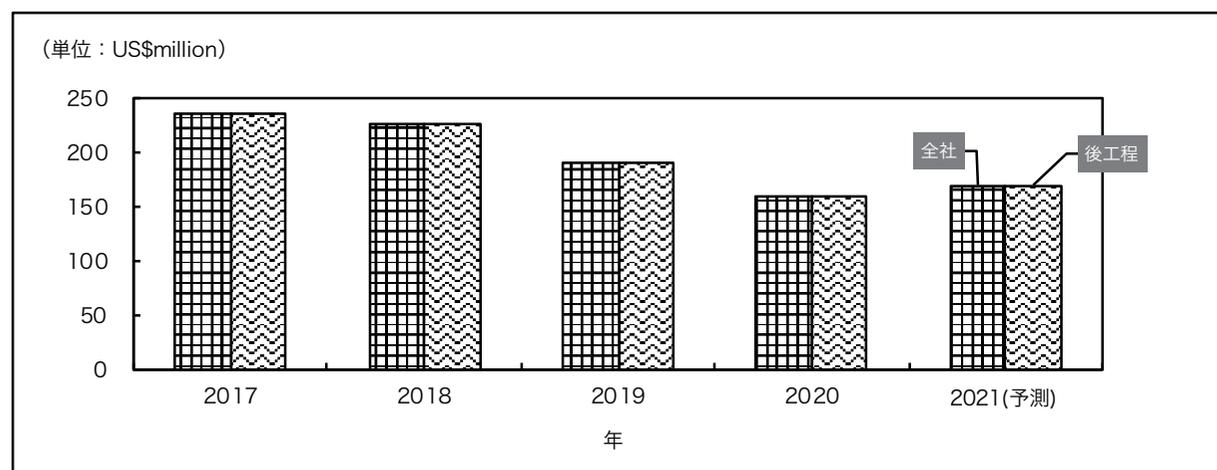
● 同社はフリップチップの技術を応用して、FCBGA、FCQFN、e-MCP などの開発に力を入れている。また、銅ピラーバンプの提供も行っている。

● 指紋センサ向けのパッケージも製造しており、成長分野に位置づけている。

4) 半導体売上状況

(単位：US\$million)

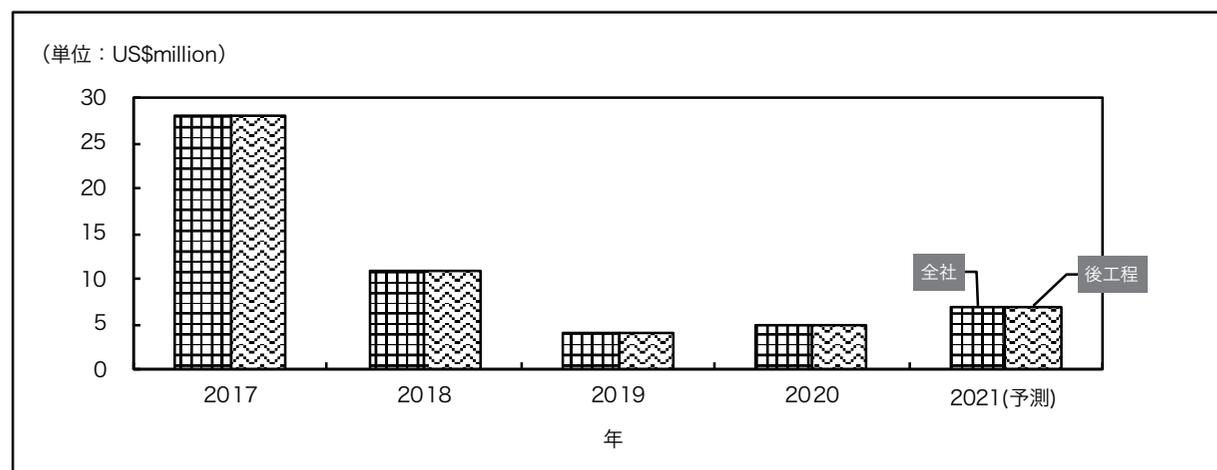
	2017	2018	2019	2020	2021(予測)
全社	235	227	191	160	170
後工程	235	227	191	160	170



5) 設備投資状況

(単位：US\$million)

	2017	2018	2019	2020	2021(予測)
全社	28	11	4	5	7
後工程	28	11	4	5	7



## 6) 工場別提供パッケージ

	本社工場
SIP	
SOP/TSOP	
DIP	
QFP	●
TQFP	●
QFN	●
COF/TCP	
BGA/FBGA	●
Stacked Die BGA	●
Flip Chip	●
CSP	●
WLCSP	●
FOWLP/FOPLP	
SiP (System in Package)	●
Power IC/Tr	
MCM	
Discrete	
IGBT	
Opto	
バンブ形成	●

## 7) 各工場のライン別一覧

企業名	Signetics Corp.
工場名	本社工場
工場所在地	483 Beopheung-ri, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
対応サービス	組立、テスト
対応製品	ロジック、メモリ
工場動向・概要	サブストレートタイプの先端パッケージの開発、製造を担っている。2017年よりS5の建設に着工しており、既に稼働を開始しているものとみられる。

ライン名	2020年			
	S1/S2/S3	S4	S5	
SIP				
SOP/TSOP				
DIP				
QFP	●			
TQFP	●			
QFN	●			
COF/TCP				
BGA/FBGA	●		●	
Stacked Die BGA	●		●	
Flip Chip	●	●	●	
CSP	●		●	
WLCSP	●		●	
FOWLP/FOPLP				
SiP (System in Package)	●		●	
Power IC/Tr				
MCM				
Discrete				
IGBT				
Opto				
バンブ形成	●			

Signetics